# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-121835

(43)Date of publication of application: 18.05.1993

(51)Int.Cl.

H01S 3/18 H01L 21/205 // H01L 21/203

(21)Application number: 03-117129

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: TANAKA TOSHIAKI

YANAGISAWA HIRONORI

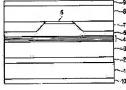
# (54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE AND MANUFACTURING METHOD

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor laser device, along with its manufacturing method, in which a shorter oscillating wavelength is realized at low threshold operation without deteriorating laser characteristics.

22.05.1991

CONSTITUTION: A semiconductor laser device comprises a buffer laver 2, a photo waveguide laver 3, an activated luminescent layer 4, a photo waveguide layer 5, a buffer layer 6, a current constriction and photo absorbent layer 7, and a contact layer 8, each formed on an n-type GaAs substrate 1. In the semiconductor laser device, an impurity is contained in at least one layer out of a quantum well layer and a quantum barrier layer that constitute the activated luminescent layer 4. Moreover, at least the activated luminescent laver is grown in an organic metal vapor phase growth method or a molecular beam epitaxial growth method.



JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### CLAIMS

### [Claim(s)]

 $\begin{array}{ll} \hbox{[Claim 1]}_a \hbox{(aluminum}_v \hbox{Ga}_{1-v} \hbox{) In}_{1-a} P \hbox{ (however, y.) characterized by comprising the following a --- respectively --- a value of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8 --- it is --- a semiconductor laser element which has the double hetero-junction which sandwiched a small luminescence active layer of forbidden-band width from it on a semiconductor substrate by a lightguide with becoming big forbidden-band width.$ 

A quantum well layer which the above-mentioned luminescence active layer turns into from a (aluminum  $_{x1}Ga_{1-x_1}$ )  $In_{1-a}P$  (however,  $x_1$  is a value of the range of  $0 \le x_1 \le y$ , and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum  $_{x2}Ga_{1-x2}$ )  $_aIn_{1-a}P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly — and this quantum barrier layer — an impurity.

[Claim 2] a(aluminum,  $Ga_{1-y}$ )  $In_{1-a}P$  (however, y.) characterized by comprising the following a — respectively — a value of the range of  $0 \le y \le 1$  and  $0.3 \le a \le 0.8$  — it is — a semiconductor laser element which has the double hetero-junction which sandwiched a small luminescence active layer of forbidden-band width from it on a semiconductor substrate by a lightguide with becoming big forbidden-band width.

A quantum well layer which the above-mentioned luminescence active layer turns into from a (aluminum  $_{x_1}$  Ga $_{1-x_1}$ ) In $_{1-a}$ P (however,  $x_1$  is a value of the range of  $0 \le x_1 \le y$ , and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum<sub>x2</sub>Ga<sub>1-x2</sub>)  $_{a}$ In<sub>1-a</sub>P (however, x<sub>2</sub> is a value of the range of x<sub>1</sub><x<sub>2</sub>(y and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly — and this quantum well layer — an impurity.

[Claim 3] a(aluminum  $_{V}$ Ga $_{1-V}$ ) In $_{1-a}$ P (however, y.) characterized by comprising the following a — respectively — a value of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8 — it is — a semiconductor laser element which has the double hetero-junction which sandwiched a small luminescence active layer of forbidden-band width from it on a semiconductor substrate by a lightguide with becoming big forbidden-band width.

A quantum well layer which the above-mentioned luminescence active layer turns into from a (aluminum  $_{x1}$  Ga $_{1-x_1}$ ) In $_{1-a}$ P (however,  $x_1$  is a value of the range of  $0 \le x_1 \le y$ , and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum  $_{\times 2}$ Ga $_{1 \to 2}$ )  $_a$ In $_{1 \to a}$ P (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly — and this quantum well layer and this quantum barrier layer — an impurity.

[Claim 4]In the semiconductor laser element according to claim 1, 2, or 3, the above–mentioned luminescence active layer, It is  ${}_a \ln_{1-a} P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) further (aluminum  ${}_{x2} Ga_{1-x2}$ ) to both sides of the above–mentioned multiple quantum well structure.  $x_1$  is a value of the above–mentioned range here — a — a value of the above–mentioned range — it is — a semiconductor laser element having a becoming optical confinement layer.

semiconductor laser element having a becoming optical confinement layer. [Claim 5]In the semiconductor laser element according to any one of claims 1 to 4, X  $_2$  in presentation (aluminum $_{\rm N2}$ Ga $_{1-\rm N2}$ )  $_2$ In $_{1-\rm a}$ P of the above-mentioned quantum barrier layer, A semiconductor laser element considering it as a value of the range of 0.4  $\leq$ X  $_2\leq$ 0.7.

[Claim 6]A semiconductor laser element characterized by band end energy of the above—mentioned quantum barrier layer being larger than that of the above—mentioned quantum well layer 0.2 eV or more in the semiconductor laser element according to any one of claims 1 to 5. [Claim 7]A semiconductor laser element characterized by a range of thickness of the above—mentioned quantum barrier layer being 4-8 nm in the semiconductor laser element according to any one of claims 1

 $\label{eq:claim 8} \begin{bmatrix} \text{Claim 8} \end{bmatrix}_{a} & \text{(aluminum}_{y} \text{Ga}_{1-y}) \text{ In}_{1-a} P & \text{(however, y.) characterized by comprising the following a --respectively --- a value of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8 --- it is --- a semiconductor laser element which has the double hetero-junction which sandwiched a small luminescence active layer of forbidden-band width from it on a semiconductor substrate by a lightguide with becoming big forbidden-band width.$ 

The upper part of a lightguide of the above-mentioned luminescence active layer upper part has heights of stripe shape in an emission direction of a laser beam, and both sides of these heights have a current stricture Kanemitsu absorption layer, and the above-mentioned luminescence active layer, (aluminum $_{J}(Ba_{1-J})$  A quantum well layer which consists of  $_{L}In_{J-D}$  (however,  $x_{1}$  is a value of the range

of  $0 \le x_1 \le y$ , and a is a value of the above-mentioned range). (aluminum  $x_2 Ga_{1-x_2}$ )  $a_1 In_{1-a} P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 \le x_2 \le y$  and) a - a value of the above-mentioned range — it is — a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly — and this quantum barrier layer — an impurity.

[Claim  $91_a$ (aluminum,  $Ga_{1-y}$ )  $In_{1-a}P$  (however, y.) characterized by comprising the following a — respectively — a value of the range of 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1

The upper part of a lightguide of the above–mentioned luminescence active layer upper part has heights of stripe shape in an emission direction of a laser beam, and both sides of these heights have a current stricture Kanemitsu absorption layer, and the above–mentioned luminescence active layer, (aluminum $_{x_1}\Omega_{a_1-x_1}$ ) A quantum well layer which consists of  $_aIn_{1-a}P$  (however,  $x_1$  is a value of the range of  $0 \le x$ ,  $\le x$ , and a is a value of the above–mentioned range).

(aluminum $_{x2}Ga_{1-x2}$ )  $_aIn_{1-a}P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 \le x_2 \le x_2$ ) and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly — and this quantum well layer — an impurity.

[Claim  $10]_a$  (aluminum,  $Ga_{1-y}$ )  $In_{1-a}P$  (however, y.) characterized by comprising the following a — respectively — a value of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8 — it is — a semiconductor laser element which has the double hetero-junction which sandwiched a small luminescence active layer of forbidden—and width from it on a semiconductor substrate by a lightguide with becoming big forbidden—

The upper part of a lightguide of the above—mentioned luminescence active layer upper part has heights of stripe shape in an emission direction of a laser beam, and both sides of these heights have a current stricture Kanemitsu absorption layer, and the above—mentioned luminescence active layer.

(aluminum $_{x1}Ga_{1-x1}$ ) A quantum well layer which consists of  $_{a}In_{1-a}P$  (however,  $x_{1}$  is a value of the range of  $0 \le x_{1} \le y$ , and a is a value of the above–mentioned range).

 $(\text{aluminum}_{\chi 2}\text{Ga}_{1-\chi 2})_{\text{a}}\text{In}_{1-\text{a}}\text{P} \text{ (however, } x_2 \text{ is a value of the range of } x_1 \leqslant x_2 \leqslant \text{y and) a } --\text{ a value of the above-mentioned range } --\text{ it is } --\text{ a becoming quantum barrier layer has at least the multiple quantum well structure established repeatedly } ---\text{ and this quantum well layer and this quantum barrier layer } ----\text{ an impurity.}$ 

[Claim 11]In the semiconductor laser element according to claim 8, 9, or 10, the above-mentioned luminescence active layer, It is  ${}_a{}^{\rm In}{}_{1-a}{}^{\rm P}$  (however,  ${}_x{}_z$  is a value of the range of  ${}_x{}_1{}^{\rm C}{}_x{}_2{}^{\rm C}{}_y$  and) further (aluminum  ${}_x{}_2{}^{\rm G}{}_1{}_{-x2}{}^{\rm P}$ ) to both sides of the above-mentioned multiple quantum well structure.  ${}_x{}_1{}$  is a value of the above-mentioned range here —  ${}_a{}^{\rm P}{}_a{}^{\rm P}{}_a{}$ 

[Claim 12]In the semiconductor laser element according to any one of claims 8 to 11, A semiconductor laser element, wherein X  $_2$  in presentation (aluminum  $_{x_2}$ Ga $_{1-x_2}$ )  $_a$ In $_{1-a}$ P of the above-mentioned quantum barrier layer considers it as a value of the range of 0.4 <=X  $_3$ <=0.7.

[Claim 13]A semiconductor laser element characterized by band end energy of the above—mentioned quantum barrier layer being larger than that of the above—mentioned quantum well layer 0.2 eV or more in the semiconductor laser element according to any one of claims 8 to 12.

[Claim 14]A semiconductor laser element characterized by a range of thickness of the above-mentioned quantum barrier layer being 4-8 nm in the semiconductor laser element according to any one of claims 8 to 13.

[Claim 15]A process of forming a lightguide which consists of  $_a$ (aluminum $_y$ Ga $_{1-y}$ ) In $_{1-a}$ P (however, y and a are the values of the range of 0< y<=1 and 0.3<-a<=0.8, respectively) on a semiconductor substrate. (aluminum $_x$ 1 Ga $_{1-x1}$ ) A quantum well layer which consists of  $_a$ In $_{1-a}$ P (however,  $_x1$ 1 is a value of the range of 0 <=x,  $_y$ 3, and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum $_{\chi 2} Ga_{1-\chi 2})_a In_{1-a} P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a becoming quantum barrier layer and constitutes a luminescence active layer. (aluminum $_y Ga_{1-y})_a In_{1-a} P$  (however, y and a are the values of the above-mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer are formed by metalorganic chemical vapor deposition, and an impurity is doped to the above-mentioned quantum barrier layer.

[Claim 16]A process of forming a lightguide which consists of a (aluminum  $_y Ga_{1-y}$ )  $In_{1-a}P$  (however, y and a are the values of the range of 0 $\le$  y $\le$ 1 and 0.3 $\le$ 4= $\le$ -0.8, respectively) on a semiconductor substrate. (aluminum  $_x IGa_{1-x1}$ ) A quantum well layer which consists of  $_a In_{1-a}P$  (however,  $x_1$  is a value of the range of 0  $\le$ x $_1$  $\le$ y, and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum $_{\chi 2}$ Ga $_{1-\chi 2}\rangle_a$ In $_{1-a}$ P (however,  $_{\chi 2}$  is a value of the range of  $_{\chi 1}$ Cx $_{\chi 2}$ Cy and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a becoming quantum barrier layer and constitutes a luminescence active layer. (aluminum $_{\chi 2}$ Ga $_{1-\chi 2}$ ) In $_{1-a}$ P (however, y and a are the values of the above-mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer are formed by metals organic chemical vapor deposition, and an impurity is doped to the above-mentioned quantum well layer.

[Claim 17]A process of forming a lightguide which consists of a (aluminum  $_y Ga_{1-y}$ )  $In_{1-a}P$  (however, y and a are the values of the range of 0 < v <= 1 and 0.3 <= a <= 0.8. respectively) on a semiconductor substrate.

(aluminum<sub>x1</sub>Ga<sub>1-x1</sub>) A quantum well layer which consists of  ${}_{a}In_{1-a}P$  (however, x<sub>1</sub> is a value of the range of 0 <=x<sub>1</sub><y, and a is a value of the above–mentioned range).

(aluminum $_{\chi 2} Ga_{1-\chi 2} \setminus aln_{1-a} P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) a — a value of the above—mentioned range — it is — a process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a becoming quantum barrier layer and constitutes a luminescence active layer. (aluminum $_y Ga_{1-y} \setminus aln_{1-a} P$  (however, y and a are the values of the above—mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above—mentioned quantum well layer and the above—mentioned quantum barrier layer are formed by metalorganic chemical vapor deposition, and an impurity is doped to the above—mentioned quantum well layer and the above—mentioned quantum barrier layer.

[Claim 18]A manufacturing method of a semiconductor laser element performing the above—mentioned metal–organic chemical vapor deposition in the range with a growing temperature of 650–750 \*\* in a manufacturing method of the semiconductor laser element according to claim 15, 16, or 17. [Claim 19]A process of forming a lightguide which consists of  $_{\bf a}$ (aluminum $_{\bf y}$  Ga $_{1-{\bf y}}$ ) In $_{1-{\bf a}}$ P (however, y and a are the values of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8, respectively) on a semiconductor substrate. (aluminum $_{\bf x}$ 1 Ga $_{1-{\bf x}}$ 1) A quantum well layer which consists of  $_{\bf a}$ In $_{1-{\bf a}}$ P (however, x $_{1}$ 1 is a value of the range of 0 <=x, y, and a is a value of the above—mentioned range).

(aluminum $_{\chi_2}Ga_{1-\chi_2}$ )  $_aIn_{1-a}P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and) a— a value of the above-mentioned range — it is — a process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a becoming quantum barrier layer and constitutes a luminescence active layer. (aluminum $_yGa_{1-y}$ )  $_aIn_{1-a}P$  (however, y and a are the values of the above-mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer are formed with molecular beam epitaxy method, and an innountivity is doped to the above-mentioned quantum barrier layer.

[Claim 20]A process of forming a lightguide which consists of  $_a$ (aluminum $_y$ Ga $_{1-y}$ ) In $_{1-a}$ P (however, y and a are the values of the range of 0 $\le$  y<=1 and 0.3<=a<=0.8, respectively) on a semiconductor substrate. (aluminum $_{x_1}$ Ga $_{1-x_1}$ ) A quantum well layer which consists of  $_a$ In $_{1-a}$ P (however,  $_x1$  is a value of the range of 0 <=x,  $_x1$ , and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum  $_{xZ}$ Ga $_{1-xZ}$ )  $_a$ In $_{1-a}$ P (however,  $_{xZ}$  is a value of the range of  $_{x1}$ C $_{x2}$ C $_{y}$  and) a — a value of the above-mentioned range — it is — a process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a becoming quantum barrier layer and constitutes a luminescence active layer. (aluminum  $_{y}$ Ga $_{1-y}$ )  $_a$ In $_{1-a}$ P (however,  $_{y}$  and a are the values of the above-mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer are formed with molecular beam epitaxy method, and an impurity is doped to the above-mentioned quantum well layer.

[Claim 21]A process of forming a lightguide which consists of  $_{\bf a}$ (aluminum $_{\bf y} {\bf Ga}_{1 \to {\bf y}}$ )  ${\bf In}_{1 \to {\bf P}}$  (however, y and a are the values of the range of 0< y<=1 and 0.3<=a<=0.8, respectively) on a semiconductor substrate. (aluminum $_{\bf x}$ 1 Ga $_{1 \to {\bf 1}}$ ) A quantum well layer which consists of  $_{\bf a}$ In $_{1 \to {\bf P}}$  (however, x $_{1}$  is a value of the range of 0 <=x, <y, and a is a value of the above-mentioned range).

(aluminum $_{x_2}Ga_{1-x_2}$ ) A process of forming multiple quantum well structure which repeats and provides a quantum barrier layer which consists of  ${}_aIn_{1-a}P$  (however,  $x_2$  is a value of the range of  $x_1 < x_2 < y$  and a is a value of the above-mentioned range), and constitutes a luminescence active layer. (aluminum ${}_yGa_{1-y}$ )  ${}_aIn_{1-a}P$  (however, y and a are the values of the above-mentioned range, respectively). It is a manufacturing method of a semiconductor laser element provided with the above, and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer are formed with molecular

beam epitaxy method, and an impurity is doped to the above-mentioned quantum well layer and the above-mentioned quantum barrier layer.

[Claim 22]A manufacturing method of a semiconductor laser element performing the above-mentioned molecular beam epitaxy method in the range with a growing temperature of 500-600 \*\* in a manufacturing method of the semiconductor laser element according to claim 19, 20, or 21.

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application]This invention relates to a short wavelength visible semiconductor laser element suitable for a light information terminal, the light source for optical application measurement, etc., and a manufacturing method for the same.

[0002]

[Description of the Prior Art]The conventional semiconductor laser element had a double hetero structure using the bulk AlGaInP by which the impurity was doped as stated, for example to JP,63-124592,A as a luminescence active layer, and about 20-nm short wavelength formation of the laser oscillation wavelength was carried out by doping of this impurity.

[0003]On the other hand, it is applied. Physics To a letter, and the 50th volume 1033 pages (1987) (Appl.Phys.Lett., Vol20., pp.1033 (1987)), the semiconductor laser element which makes a luminescence active layer quantum well structure is indicated.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]In order to bring about increase of a defect, and decline in luminous efficiency in order that the above-mentioned conventional technology may dope a high-concentration impurity to an active region, and to increase the optical loss by a free carrier, there was a problem of having raised the threshold current of an element or reducing reliability. It was not clear about the impurity concentration level which does not spoil a laser characteristic. Impurity doping when the luminescence active layer was made into quantum well structure was not described, and it was not clarified about the design about the quantum well structure for obtaining a short-wavelength-laser oscillation.

[0005]The purpose of this invention is to provide the semiconductor laser element which carried out laser oscillation with short wavelength, and operated by low threshold current, and introduced quantum well structure into the luminescence active layer.

[0006]Other purposes of this invention are to provide the manufacturing method of such a semiconductor laser element.

[0007]

#### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **MEANS**

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

  3.In the drawings, any words are not translated.

### OPERATION

[Function]4 yuan mix crystal (aluminum,  $Ga_{1-y}$ )  $_a$ In $_{1-a}$ P which grew the operation of this invention epitaxially on the GaAs substrate is explained as an example. The value of a for carrying out lattice matching of this mix crystal to a substrate is 0.51. Now, the order arraying structure of group III elements has arisen, and a  $_{A(IGa)0.51}^{1}$ In $_{0.49}^{0}$ P mix crystal has small bandgap energy. In this invention, bandgap energy of an active layer is enlarged by controlling the order arraying structure of the group III elements in a  $_{A(IGa)0.51}^{1}$ In $_{0.49}^{0}$ P mix crystal by impurity doping.

[0015] for example, Japanese Journal of Applied Physics and the 28th — as shown in volume (1989) L2092 page—L2094 page (Jpn J.Appl.Phys., 28(1989)L2092—L2094), [ however, ] It is known that luminescence intensity may decrease by impurity doping. This is considered to be because for a defect to be increased in an AlGaInP mix crystal by impurity doping and for luminous efficiency to fall. For this reason, threshold current may be increased although short wavelength formation of the laser oscillation wavelength can be carried out by doping an impurity to a luminescence active layer.

[0016] especially a desirable structure of this invention — multiple quantum well structure \*\*\*\* — it is the structure which became irregular only to the quantum barrier layer without doping an impurity to the quantum well layer from which a profit is acquired, and doped the impurity. It can expect to be able to increase the barrier energy of a quantum barrier layer and to carry out laser oscillation with short wavelength more, without reducing by this the luminous efficiency of the quantum well layer which is an active region.

[0017]For example, photoluminescence peak wavelength and the relation of GaInP quantum well layer thickness are shown in <u>drawing 2</u>, and are explained. As opposed to peak wavelength being 665 nm (\*\* seal of a figure) in the conventional undoped GaInP bulk active layer grown up by metal-organic chemical vapor deposition, In undoped multiple quantum well structure (undoping (aluminum<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>) <sub>0.51</sub>In<sub>0.49</sub>P quantum barrier layer of the undoped GaInP quantum well layer of 3 nm of thickness, and 4 nm of thickness), it is 626 nm (O seal of a figure), When a p type impurity was doped to a quantum barrier layer by the multiplex quantum well active layer of the same thickness, it was 620 nm (- seal of a figure). These values the peak wavelength in the case of being a case where a <sub>(aluminum<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>,50.51</sub>In<sub>0.49</sub>P

quantum barrier layer is order arraying structure, and disorderly arraying structure, It was well in agreement with the case of 3 nm of thickness of the calculated value (a dotted line and a solid line show to a figure, respectively) computed using bandgap energy 570nm and 551 nm, respectively. [0018]When an impurity is doped to a (aluminum<sub>0.5</sub>Ca<sub>0.5</sub>N0.51In<sub>0.49</sub>P quantum barrier layer here, barrier

energy, It was equivalent to the bandgap energy of the (aluminum<sub>0.65</sub>Ga<sub>0.35</sub>/0.51In<sub>0.49</sub>P layer of Al

composition 0.65 in the case of being undoped. This shows that a short—wavelength—laser oscillation is possible by the impurity abnormal—conditions dope to a quantum barrier layer. In this invention, when the abnormal—conditions dope of the impurity was carried out at a quantum barrier layer, the laser oscillation wavelength of 630–635 nm was obtained, and the oscillation wavelength shorter 5–6 nm than the undoped time has been realized. Since a profit would be acquired by the career of the quantum barrier layer which carried out the impurity dope further, without bringing about increase of a defect, and decline in luminous efficiency when not having doped the impurity to a quantum well layer, increase of

differential gain and low threshold operation have been attained.
[Translation dans ]

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### FXAMPI F

the oscillation wavelength.

[Fxample] The sectional view of the semiconductor laser element of one example of example 1 this invention is shown in drawing 1, and the manufacturing method is explained. By the metal-organic chemical vapor deposition explained in full detail behind, it is n type GaAs buffer layer 2 (0.5 micrometer in thickness.) on the n type GaAs substrate 1, Concentration-of-electrons no=1x10 18 cm<sup>-3</sup>, The n type (aluminum<sub>0.7</sub>Ga<sub>0.3</sub>) <sub>0.51</sub>In<sub>0.49</sub>P lightguide 3 (1.5-micrometer [ in thickness ] and concentration-ofelectrons n<sub>5</sub>=1x10 <sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>) and the luminescence active layer 4 are grown epitaxially. The luminescence active layer 4 is a structure shown below. Namely, this layer, (aluminum<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>) 0.51In<sub>0.49</sub>P of 4 nm of thickness which doped ten layers of undoped  ${
m Ga_{0.51}}{
m In_{0.49}}{
m P}$  quantum well layers of 3 nm of thickness, and p type impurity Zn (hole concentration  $n_A=6-9x10^{-17} cm^{-3}$ ). It is the multiple quantum well structure by which nine layers of quantum barrier layers were provided by turns, and the (aluminum Gao 5)0.51 In 0.49 P optical confinement layer of 15 nm of thickness was provided in the both sides. [0020]Next, the p type (aluminum 7Ga 3) 051In 49 lightguide 5 (1.2 micrometers in thickness.) The hole concentration n<sub>A</sub>=5 - 7x10 <sup>17</sup>cm<sup>-3</sup> and p type Ga<sub>0.51</sub>In<sub>0.40</sub>P buffer layer 6 (0.05-micrometer [ in thickness ] and hole concentration  $n_{\Delta}$ =2x10  $^{18}$ cm $^{-3}$ ) is grown epitaxially similarly. [0021]Next, a SiO<sub>2</sub> mask (thickness of 0.2 micrometer, stripe width of 5 micrometers) is formed by photo lithography, etching removal of the buffer layer 6 and the lightguide 5 is carried out till the place which leaves 0.2 micrometer of lightguides 5 by chemical etching, and a ridge stripe is formed. [0022]Next, selective growth of the n type GaAs current stricture Kanemitsu absorption layer 7 (1.0micrometer [ in thickness ] and concentration-of-electrons n<sub>D</sub>=2x10 <sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>) is carried out, with a SiO, mask left. After embedding p type GaAs contact layer 8 (the concentration of electrons of 1-micrometer [ in thickness ] and concentration-of-electrons n<sub>A</sub>=5x10 <sup>18</sup> - 1x10 <sup>19</sup>cm<sup>-3</sup>, and the upper part is high) and growing up it, the p electrode 9 and the n electrode 10 are vapor-deposited. A cleavage scribe is carried out, it starts in the form of an element, and a laser device is obtained. [0023]Metal-organic chemical vapor deposition was performed by the growing temperature of 700 \*\*. and pressure 70Torr as trimethylgallium and a raw material of In as trimethylaluminum and a raw material of Ga as a raw material of aluminum, using phosphine as trimethylindium and a raw material of P. Dimethyl zinc was used for the quantum barrier laver as a raw material which carries out the abnormalconditions dope of the Zn which is a p type impurity. [0024] The band end energy of the quantum barrier layer in the above-mentioned multiple quantum well

structure is higher than that of a quantum well layer 0.42 eV. In the room temperature, threshold current operated at 40-50 mA, and the laser device of this example was 630-635 nm in the laser oscillation wavelength. In the element which does not dope an impurity to a quantum barrier layer, since the threshold current in a room temperature was 60-70 mA and the laser oscillation wavelength was 636-640 nm, this invention has realized low threshold current operation and short wavelength formation of

[0025]The portion of the multiple quantum well structure which constitutes the example [ of two shots ] photoactive layer 4 was replaced with as follows, and also the laser device was manufactured like Example 1. that is, Multiple quantum well structure. P type impurity Zn. A dope. (Hole concentration  $n_{\text{A}}$ =6  $-9\times10^{-17}\text{cm}^{-3}$ ) Ten layers of Ga $_{0.51}$ In $_{0.49}$ P quantum well layers of 3 nm of thickness and nine layers of

undoping (aluminum<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>) <sub>0.51</sub>In<sub>0.49</sub>P quantum barrier layers of 4 nm of thickness which were carried out. It was considered as the structure where it was provided in \*\*\*\*\*\* and the (aluminum<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>)
<sub>0.51</sub>In<sub>0.49</sub>P optical confinement layer of 15 nm of thickness was provided in the both sides.

0.51In.0.49° optical continement layer of 13 him of thickness was provided in the both sides. [0026] The band end energy of the quantum barrier layer in this multiple quantum well structure is higher than that of a quantum well layer 0.33 eV. In the room temperature, threshold current operated at 60–70 mA, and the laser device of this example was 630–635 nm in the laser oscillation wavelength. From the element which does not dope an impurity, the laser oscillation wavelength was able to carry out about 5–10-nm short wavelength formation.

[0027]The portion of the multiple quantum well structure which constitutes the example [ of three shots ] photoactive layer 4 was replaced with as follows, and also the laser device was manufactured like Example 1. Namely, multiple quantum well structure is provided in ten layers of  $G_{0.51}In_{0.49}P$  quantum well layers of 3 nm of thickness, and nine layers of  $(aluminum_{0.5}Ga_{0.5})0.51In_{0.49}P$  quantum barrier layers of 4 nm of thickness by turns, P type impurity Zn was doped in all the layers of the structure where the  $(aluminum_{0.5}Ga_{0.5})0.51In_{0.49}P$  optical confinement layer of 15 nm of thickness was provided in the both

sides (hole concentration  $n_A=6-9\times10^{-17}$ cm<sup>~3</sup>).

[0028]The band end energy of the quantum barrier layer in this multiple quantum well structure is higher than that of a quantum well layer 0.36 eV. In the room temperature, threshold current operated at 60–80 mA, and the laser device of this example was 625–630 nm in the laser oscillation wavelength. From the element which does not dope an impurity, the laser oscillation wavelength was able to carry out about 10–15–nm short wavelength formation.

[0029]In the above example, each class grown up by metal-organic chemical vapor deposition was grown up with molecular beam epitaxy method, respectively, and the laser device was manufactured similarly. In this case, it carried out by the growing temperature of 550 \*\*\*, and 10°\*5 rr, using the phosphine as aluminum, Ga, In, and a raw material of P as a raw material. Each of each manufactured laser devices showed the same effect as each laser device manufactured by metal-organic chemical vapor deposition. [0030]Whether replace with this and it uses Mg and Be, although Zn was used for the above example as an impurity doped to a luminescence active layer, or it used Si of a n type impurity, and Se, the almost same result was obtained.

#### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## EFFECT OF THE INVENTION

[Effect of the Invention]or [ carrying out the abnormal–conditions dope of the impurity at a quantum barrier layer or a quantum well layer according to this invention ] — or the thing which multiple quantum well structure boils all and is doped — the laser device oscillated more with short wavelength has been realized.

[0032]Since barrier energy of the quantum barrier layer was enlarged by carrying out the abnormalconditions dope especially of the impurity at a quantum barrier layer, quantum level energy increased and
the laser device oscillated more with short wavelength has been realized. Since the profit was acquired
by the career in the quantum barrier layer which carried out the impurity dope, without causing increase
of a defect, and decline in luminous efficiency when not doping an impurity to a quantum well layer, the
laser device which operates by low threshold current was obtained.

[0033]Remarkable degradation was not seen even if the laser device of this invention passed for about 2000 hours in the life test of the temperature of 50 \*\*, and 3-mW constant optical power operation.

#### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is a section structure figure of the semiconductor laser element of one example of this invention.

[Drawing 2][It is a figure showing photoluminescence peak wavelength and the relation of quantum well layer thickness.

[Description of Notations]

- 1 N type GaAs substrate
- 2, 6 buffer layers
- 3 Lightguide
- 4 Luminescence active layer
- 5 Lightguide
- 7 Current stricture Kanemitsu absorption layer
- 8 Contact layer
- 9 p electrode
- 10 n electrode

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-121835

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51)Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 S 3/18		9170-4M		
H 0 1 L 21/205		7454-4M		
// H 0 1 L 21/203	M	8422-4M		

# 審査請求 未請求 請求項の数22(全 10 頁)

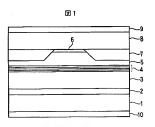
(21)出願番号	特顯平3-117129	(71)出願人	000005108
(00) III 86 F	平成3年(1991)5月22日		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成3年(1991)5月22日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者	
			東京都国分寺市東恋ケ経1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	柳沢 浩徳
			東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(74)代理人	弁理士 薄田 利幸 (外1名)

# (54) 【発明の名称 】 半導体レーザ素子及びその製造方法

#### (57) 【要約】

【目的】 レーザ特性を損わずに低閾値動作でより短い発 振波長を実現する半導体レーザ素子及びその製造方法を 提供すること。

【構成】 n型G a A s 基板1上に、バッファ層 2、光導 波層 3、 発光活性層 4、光端波層 5、バッファ層 6、電 流染窄兼光吸収層 7、コンタクト層 8を有するレーザ素 子であり、発光活性層 4を機成する量子井戸障と量子障 壁層の少なくとも1方の層に不純物を含有させる。この レーザ素子の少なくとも発光活性層は有機金属気相成長 法か分子線エピタキシー法によりエピタキシャル成長さ せて形成する。



1--- n 型GaAs 基板 2.6--- バッファ信 3--- 光等液信 4--- 発光: 活性信 5--- 光等液信 8--- コンタット信 9--- P 電極 10--- 電極

### 【特許請求の範囲】

【請求項』】  $(A 1, G a_{1r}) \cdot 1 n_{1r} P$  (ただしy、 本行 a はそれぞれ0 < y ≤ 1、0、3 ≤ a ≤ 0、8 の範囲の 値である) よりなる禁制帯幅の大きな光滞衰弱により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルへ、テロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記衆光活性層は、 $(1 1 a_{1r} G a_{1ra}) \cdot 1 n_{1r} P$  (ただし $x_1$ は $0 \le x_1 < y$ 0 の範囲の値であり、a は上記の範囲の値であり、 $x_1 < x_2 < y$ 0 の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、 $(A 1 a_{1r} G a_{1ra}) \cdot 1 n_{1r} P$  (ただし $x_1$ は $x_1 < x_2 < y$ 0 の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、 $(A 1 a_{1r} G a_{1ra}) \cdot 1 n_{1r} P$  (ただし $x_1$ は $x_1 < x_2 < y$ 0 の範囲の値である)よりなる量子神戸層とが繰り返し設けられた多重量子井下構造を少なくとも有し、かつ該量子障壁層に不純物を有することを特徴とする半導体レーザ素子。

1

【請求項3】 (A1, Gair、)・1 ni・P (ただしy。 a はそれぞれのくy≤1、0、3≤a≤0.8の範囲の値である)よりなる熱制帯の大きな光準数略により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルへテロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記光活性層は、(A1a Gairi、)・1 ni・P (ただしx, はむらx;とyの範囲の値であり、a は上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、(A1a Gairi、)・1 ni・P (ただしx, はx, 4x;くyの範囲の値である)よりなる量子井戸層とが最大のなの表しまりなる量子沖縄をとか繰り返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有し、かつ該量子井戸層と該量子井戸構造を少なくとも有し、かつ該量子井戸幕と該量子井戸構造を少なくとも有し、かつ該量子井戸幕と変量とで乗りなくとき有し、かつ該量マ井戸幕と変量とで乗りなくときを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項4】請求項1、2又は3記載の半導体レーザ素 子において、上記発光活性層は、上記多重量子井戸構造 の両側にきちに(A1。Ga1。)。1n:, P (ただし x:はx:<x:<yの範囲の値であり、ここにx:は上記 の範囲の値であり、aは上記の範囲の値である)よりな る光閉じ込め層を有することを特徴とする半導体レーザ 素子。

7の範囲の値とすることを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項6】請求項1から5のいずれか一に記載の半導体レーザ素子において、上記量子連整層のバンド端エネルギーは、上記量子井戸層のそれよりも0.2 e V以上大きいことを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項7】請求項1から6のいずれか一に記載の半導体レーザ素子において、上記量子障壁層の膜厚は、4~8nmの範囲であることを特徴とする半導体レーザ素

【請求項8】(A1 $_{\rm I}$ G  $a_{\rm IT}$ )、1  $n_{\rm IT}$  P(ただしy。 aはそれぞれ0 < y  $\leq$  1、0、3  $\leq$  a  $\leq$  0、8 の範囲の値である)よりなる禁制帯幅の大きな光潮波層により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記発光活性層の上側の光波形像の上間が表現の一部で、一部大の出射方向にストライブ状の凸部を有し、終凸部の両側は電流鉄窄兼光吸収層を有し、上記発光活性層は、(A1 $_{\rm I}$ G  $a_{\rm IT}$  $a_{\rm$ 

**職壁層に不純物を有することを特徴とする半導体レーザ** 

案で・
【請來項9】( $A 1, G a_{17}$ )。 $1 n_{18}$  P(ただしy、 a はそれぞれ $0 < y \le 1$ 、0.  $3 \le a \le 0$ . 8 の範囲の
値である)よりなる禁制帯幅の大きな光海茨層により、
30 それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルへ
アロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記発光活性層の上側の光導波層の上部は、レーザ光の出射方向にストライブ状の凸形を有し、上記発光活性層は、( $A 1 a G a_{14}$ )。 $1 n_{18}$  P(ただし $x_1$ は $0 \le x_1 < y$  の範囲の値であり、a は上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、( $A 1 a G a_{14}$ )。 $1 n_{18}$  P(ただし $x_1$ は $0 \le x_2$  をしまれは $x_1 < x_2 < y$  の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、( $a 1 a G a_{14}$ )。a は上記の範囲の値である)よりなる量子井戸構造を少なくとも有し、かつ該量子井戸層に不純物を有することを特徴とする半導体レーザ素子。

【請来項 1 0 1 (A 1, G a 1, 7) ≥ 1 n 1; P (ただし y、a はそれぞれ0 < y ≤ 1、0 3 ≤ a ≤ 0.8 の範 田の値である) よりなる禁制帯幅の大きな光等換層により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記発光活性層の一切光準液層の上部は、レーザ次の凸部を有し、該色の両側は電波狭窄兼光吸収層を有し、上記発光活性層

は、(Alu Gain )。Inio P (ただしxiは0≦ x:<vの範囲の値であり、aは上記の範囲の値であ る) よりなる量子井戸層と、(Alg Garg)。In P (ただしxzはxi < xz < y の範囲の値であり、a</p> は上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層とが繰り 返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有し、か つ該量子井戸層と該量子障壁層とに不純物を有すること を特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項11】請求項8、9又は10記載の半導体レー ザ素子において、上記発光活性層は、上記多重量子井戸 10 構造の両側にさらに (Ala Gana) . Inio P (た だし $x_1$ は $x_1$ < $x_2$ <yの範囲の値であり、ここに $x_1$ は 上記の範囲の値であり、aは上記の範囲の値である)よ りなる光閉じ込め層を有することを特徴とする半導体レ ーザ素子。

【請求項12】請求項8から11のいずれか一に記載の 半導体レーザ素子において、上記量子障壁層の組成(A l 2 Ga 1-2 ) . In 1- PにおけるX2は、0. 4≦X2 ≤0.7の範囲の値とすることを特徴とする半導体レー ザ素子。

【請求項13】請求項8から12のいずれか―に記載の 半導体レーザ素子において、上記量子障壁層のバンド端 エネルギーは、上記量子井戸層のそれよりも0.2eV 以上大きいことを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項14】請求項8から13のいずれか―に記載の 半導体レーザ素子において、上記量子障壁層の膜厚は、 4~8 nmの範囲であることを特徴とする半導体レーザ 素子。

【請求項15】半導体基板上に、(Al, Gai, )。I nia P (ただしy、aはそれぞれ0<y≤1、0.3 ≤ a ≤ 0.8の範囲の値である)よりなる光導波層を形 成する工程と、(Ala Gain )。Inia P (ただし  $x_1$ は $0 \le x_1 < v$ の範囲の値であり、aは上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Alz Garz) 。Inia P (ただしx2はx1<x2<vの範囲の値であ り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gair)。Inio P (た だしv、aはそれぞれ上記の鉱囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ 40 ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、有機金属気相成長法により形成し、かつ 上記量子障壁層に不純物をドープすることを特徴とする 半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項16】半導体基板上に、(A1, Gair)。I ≤ a ≤ 0. 8の範囲の値である)よりなる光導波層を形 成する工程と、(Alm Gara )。Inia P (ただし x1は0≤x1<yの範囲の値であり、aは上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Ala Gara )。 50 成する工程と、(Ala Gara )。Inic P (ただし

In: P (ただしx2はx1<x2<vの範囲の値であ り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gai, ). Inia P (た だしv、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、有機金属気相成長法により形成し、かつ 上記量子井戸層に不純物をドープすることを特徴とする 半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項17】半導体基板上に、(A1, Gair)。! n = P (ただしv、aはそれぞれ0<v≤1、0.3 ≤a≤0.8の範囲の値である)よりなる光導波層を形 成する工程と、 (Alm Garet )。In: P (ただし  $x_1$ は $0 \le x_1 < y$ の範囲の値であり、aは上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Alz Gara)。 In:a P (ただしx2はx1 < x2 < vの範囲の値であ り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gai, )。Inio P (た だしy、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、有機金属気相成長法により形成し、かつ 上記量子井戸層及び上記量子障壁層に不純物をドープす ることを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項18】請求項15、16又は17記載の半導体 レーザ素子の製造方法において、上記有機金属気相成長 法は、成長温度650~750℃の範囲で行うことを特 30 微とする半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項19】半導体基板上に、(A1, Gai, )。I ≤a≤0.8の範囲の値である)よりなる光導波層を形 成する工程と、(Ala Gain )。Inio P (ただし  $x_1$ は0  $\leq x_1 < y$ の範囲の値であり、aは上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Ala Gaina) Inia P (ただしx2はx1<x2<vの範囲の値であ</li> り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gai, ), Ini, P(た だしy、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、分子線エピタキシー法により形成し、か つ上記量子障壁層に不練物をドープすることを特徴とす る半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項20】半導体基板上に、(Al, Gal, ), I n<sub>1</sub>, P (ただしv、aはそれぞれ0<v≤1、0.3 ≦a≤0.8の範囲の値である)よりなる光導波層を形 x, は  $0 \le x$ , < y の範囲の値であり、 a は上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Alz Garz)。 lnia P (ただしx2はx1<x2<yの範囲の値であ り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gair)。lnia P (た だしv、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、分子線エピタキシー法により形成し、か 10 つ上記量子井戸層に不純物をドープすることを特徴とす る半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項21】半導体基板上に、(Al,Gai,)。I  $n_{i*}$  P (tE), a tEtA ≤ a ≤ 0 . 8 の範囲の値である)よりなる光導波層を形 成する工程と、 (Ala Gara )。Inia P (ただし  $x_1$ は $0 \le x_1 < y$ の範囲の値であり、a は上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(A 1 z Ga:-z )。I  $n_1$  P (ただし $x_2$ は $x_1 < x_2 < y$ の範囲の値であり、 a は上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層とを繰 20 り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構造を 形成する工程と、(Al, Gai, )。Ini。 P (ただし v、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる光導 波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レーザ 素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記量子 障壁層は、分子線エピタキシー法により形成し、かつ上 記量子井戸層及び上記量子障壁層に不純物をドープする ことを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法。

【請求項22】請求項19、20又は21記載の半導体 レーザ素子の製造方法において、上記分子線エピタキシ 30 一法は、成長温度500~600℃の範囲で行うことを 特徴とする半導体レーザ素子の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光情報端末や光応用計 測用の光源等に適した短波長可視半導体レーザ素子及び その製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の半導体レーザ素子は、例えば特開 昭63-124592に述べられているように、不純物 40 がドーピングされたバルクAIGaInPを発光活性層 として用いたダブルヘテロ構造を持ち、この不純物のド ーピングによって、レーザ発振波長は約20nm短波長 化していた。

【0003】一方、アプライド フィジックス レタ -, 第50巻1033頁 (1987) (Appl. Ph ys. Lett., Vol 20., pp 1033 (19 87)) には発光活性層を量子井戸構造とする半導体レ ーザ素子が記載されている。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、活性 領域に高濃度の不純物をドーピングするために欠陥の増 大や発光効率の低下をもたらし、また自由キャリアによ る光損失を増大させるため、素子の閾値電流を上昇させ たり信頼性を低下させるという問題があった。また、レ ーザ特性を損わない不純物濃度レベルについて明らかで なかった。さらに、発光活性層を量子井戸構造としたと きの不純物ドーピングについては述べられておらず、短 波長レーザ発振を得るための量子井戸構造に関する設計 については明らかにされていなかった。

【0005】本発明の目的は、短波長でレーザ発振し、 低閾値電流で動作し、かつ発光活性層に量子井戸構造を 導入した半導体レーザ素子を提供することにある。 【0006】本発明の他の目的は、そのような半導体レ ーザ素子の製造方法を提供することにある。

# [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、(1) (A l,Gai,)。Ini。P(ただしy、aはそれぞれ0< v≤1、0.3≤a≤0.8の範囲の値である) よりな る禁制帯幅の大きな光導波層により、それより禁制帯幅 の小さい発光活性層を挟んだダブルヘテロ接合を半導体 基板上に有する半導体レーザ素子において、上記発光活 性層は、(Ala Gara )。Inio P (ただしxiは  $0 \le x_1 < y$ の範囲の値であり、aは上記の範囲の値で ある) よりなる量子井戸層と、(Ala Gaina)。I n: P (ただしx2はx1<x2<yの範囲の値であり、 aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層とが繰 り返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有し、 かつ該量子障壁層に不練物を有することを特徴とする半 導体レーザ素子、(2) (Al, Gair), Ini, P (t,t) (t,t) t (t,t) 0. 8の範囲の値である)よりなる禁制帯幅の大きな光 導波層により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を 棟んだダブルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体 レーザ素子において、上記発光活性層は、(Alu Ga 1-1 ) , I n := P (ただしx : は0 ≤ x : < y の範囲の値</p> であり、aは上記の範囲の値である) よりなる量子井戸 層と、(Ala Gaina) Inin P (ただしx2はx1 < x2 < yの範囲の値であり、a は上記の範囲の値であ る) よりなる量子障壁層とが繰り返し設けられた多重量 子井戸構造を少なくとも有し、かつ該量子井戸層に不純 物を有することを特徴とする半導体レーザ素子、(3) (Al, Gair, ) alnia P (ただしy、aはそれぞれ 0 < y ≦ 1 、0.3 ≦ a ≦ 0.8の範囲の値である)よ りなる禁制帯幅の大きな光導波層により、それより禁制 帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブルヘテロ接合を半 導体基板上に有する半導体レーザ素子において、上記発 光活性層は、 (Ala Gara) 。Inia P (ただしx  $_1$ は $0 \le x_1 < y$ の範囲の値であり、a は上記の範囲の値 50 である) よりなる量子井戸層と、(Aliz Gainz)。

(5)

In: P (ただしx2はx1<x2<yの範囲の値であ り、a は上記の範囲の値である) よりなる量子障壁層と が繰り返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有 し、かつ該量子井戸層と該量子障壁層とに不純物を有す ることを特徴とする半導体レーザ素子、(4)上記1、 2 又は3 記載の半導体レーザ素子において、上記発光活 性層は、上記多重量子井戸構造の両側にさらに(Ala  $Ga_{1=2}$ ) ,  $In_{1=}$  P (ただし $x_2$ は $x_1 < x_2 < y$ の範 囲の値であり、ここにx1は上記の範囲の値であり、a は上記の範囲の値である)よりなる光閉じ込め層を有す ることを特徴とする半導体レーザ素子、(5)上記1か ら4のいずれか一に記載の半導体レーザ素子において、 上記量子障壁層の組成 (Alz Garz )。Inia Pに おけるX<sub>2</sub>は、0. 4≤X<sub>2</sub>≤0. 7の範囲の値とするこ とを特徴とする半導体レーザ素子、(6)上記1から5 のいずれか一に記載の半導体レーザ素子において、上記 量子臓壁層のバンド端エネルギーは、上記量子井戸層の それよりも0.2eV以上大きいことを特徴とする半導 体レーザ素子、(7)上記1から6のいずれか一に記載 の半導体レーザ素子において、上記量子障壁層の膜厚 は、4~8 nmの範囲であることを特徴とする半導体レ ーザ素子、(8) (Al, Gair, ), Inio P (ただし y、a はそれぞれ0<y≤1、0.3≤a≤0.8の範 囲の値である)よりなる禁制帯幅の大きな光導波層によ り、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだダブ ルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ素子 において、上記発光活性層の上側の光導波層の上部は、 レーザ光の出射方向にストライプ状の凸部を有し、該凸 部の両側は電流狭窄兼光吸収層を有し、上記発光活性層 は、(Alm Gaim ) . Inim P (ただしxiは0≦ x1< yの範囲の値であり、a は上記の範囲の値であ る) よりなる量子井戸層と、 (Alz Garz )。In 1-8 P (ただしx2はx1 < x2 < yの範囲の値であり、a は上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層とが繰り 返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有し、か つ該量子障壁層に不純物を有することを特徴とする半導 体レーザ素子、(9) (Al, Gair) , Inia P (た だしy、aはそれぞれ $0 < y \le 1$ 、0.  $3 \le a \le 0$ . 8の範囲の値である) よりなる禁制帯幅の大きな光導波層 により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を挟んだ 40 ダブルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体レーザ 素子において、上記発光活性層の上側の光導波層の上部 は、レーザ光の出射方向にストライプ状の凸部を有し、 該凸部の両側は電流狭窄兼光吸収層を有し、上記発光活 性層は、 (Ala Gala ) . Ini. P (ただしxiは 0≤x1<yの範囲の値であり、aは上記の範囲の値で ある) よりなる量子井戸層と、(Alz Ganz). I n: P (ただしx: はx: < x2 < yの範囲の値であり、 a は上記の範囲の値である) よりなる量子障壁層とが繰 り返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有し、

かつ該量子井戸層に不純物を有することを特徴とする半 導体レーザ素子、(10)(Al, Gai, )。Ini。 P (ただしv、aはそれぞれ $0 < v \le 1$ 、0,  $3 \le a \le$  8の範囲の値である)よりなる禁制帯幅の大きな光 導波層により、それより禁制帯幅の小さい発光活性層を 挟んだダブルヘテロ接合を半導体基板上に有する半導体 レーザ素子において、上記発光活性層の上側の光導波層 の上部は、レーザ光の出射方向にストライプ状の凸部を 有し、該凸部の両側は電流狭窄兼光吸収層を有し、上記 発光活性層は、 (Alu Gara )。Into P (ただし  $x_1$ は $0 \le x_1 < y$ の範囲の値であり、a は上記の範囲の 値である) よりなる量子井戸層と、(Alz Gazz) Ini。 P (ただしx2はx1<x2<yの範囲の値であ</li> り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と が繰り返し設けられた多重量子井戸構造を少なくとも有 し、かつ該量子井戸層と該量子障壁層とに不純物を有す ることを特徴とする半導体レーザ素子、(11)上記 8、9又は10記載の半導体レーザ素子において、上記 発光活性層は、上記多重量子井戸構造の両側にさらに (Ala Gara) Inr P (ただしxzはx1 < x2 < yの範囲の値であり、ここにx1は上記の範囲の値で あり、aは上記の範囲の値である)よりなる光閉じ込め 層を有することを特徴とする半導体レーザ素子、(1) 2) 上記8から11のいずれか一に記載の半導体レーザ 素子において、上記量子障壁層の組成(AlaG  $a_{1-2}$ ) ,  $I_{n_{1-}}$  PK $\sharp that X_2 that 0. <math>4 \le X_2 \le 0$ . 7の範囲の値とすることを特徴とする半導体レーザ素 子、(13)上記8から12のいずれか一に記載の半導 体レーザ素子において、上記量子障壁層のバンド端エネ ルギーは、上記量子井戸層のそれよりも0.2eV以上 大きいことを特徴とする半導体レーザ素子、(14)上 記8から13のいずれか一に記載の半導体レーザ素子に おいて、上記量子障壁層の膜厚は、4~8 nmの範囲で あることを特徴とする半導体レーザ素子によって達成さ

【0008】上記他の目的は、(15) 半導体基板上に、(A1,Ga<sub>11</sub>)。In<sub>11</sub> P (ただしy、aはそれぞれのくy≤1,0、3≤≤0.8の範囲の値である)よりなる光導波層を形成する工程と、(A1。Ga<sub>1</sub>,0)。In<sub>1</sub> P (ただしx,ix、<yの範囲の値であり、aは上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層と、(A1。Ga<sub>1</sub>,0)。In<sub>1</sub> P (ただしx,ix、<xx、<yの範囲の値であり、aは上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層を形成する工程と、(A1,Ga<sub>11</sub>)。In<sub>11</sub> P (ただしy、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層途を形成する工程と、(A1,Ga<sub>11</sub>)。In<sub>11</sub> P (ただしy、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる光導波層を形成する工程とと少なくとも有する半導体レーザ楽子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記量子障壁層は、有機金属気相成を提出より形成し、かつ上記量子障壁層は、有機金属気

(6)

Q

ドープすることを特徴とする半導体レーザ素子の製造方 法、(16) 半導体基板上に、(A1, Gai, )。In P (ただしv、aはそれぞれ0<y≤1、0.3≤</p> a ≤ 0. 8 の範囲の値である)よりなる光導波層を形成 する工程と、(Alu Gain )。Inia P (ただしx 」は0≤x1<yの範囲の値であり、aは上記の範囲の値 である) よりなる量子井戸層と、(Alz Gara)。 In1-a P (ただしx2はx1<x2<yの範囲の値であ り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 10 造を形成する工程と、(Al, Ga,,). In, P(た だしv、aはそれぞれ上記の範囲の値である)よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、有機金属気相成長法により形成し、かつ 上記量子井戸層に不純物をドープすることを特徴とする 半導体レーザ素子の製造方法、(17)半導体基板上 に、(Al, Gair,)。Inia P (ただしy、aはそれ ぞれ0<y≤1、0.3≤a≤0.8の範囲の値であ る) よりなる光導波層を形成する工程と、(Alu Ga i-ri )。In:。 P (ただしx:は0≦x:<yの範囲の値 であり、aは上記の範囲の値である)よりなる量子井戸 層と、(Ala Gana), Ini P (ただしx2はx1 < x2 < yの範囲の値であり、a は上記の範囲の値であ る)よりなる量子障壁層とを繰り返し設け、発光活性層 を構成する多重量子井戸構造を形成する工程と、(A1 、Gair )。Inia P (ただしv、aはそれぞれ上記の 範囲の値である) よりなる光導波層を形成する工程とを 少なくとも有する半導体レーザ素子の製造方法におい て、上記量子井戸層及び上記量子障壁層は、有機金属気 30 相成長法により形成し、かつ上記量子井戸層及び上記量 子障壁層に不純物をドープすることを特徴とする半導体 レーザ素子の製造方法、(18)上記15、16又は1 7記載の半導体レーザ素子の製造方法において、上記有 機命属気相成長法は、成長温度650~750℃の範囲 で行うことを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法、 (19) 半導体基板 上に、(Al, Gar, )。Into P (ただしy、aはそれぞれ $0 < y \le 1$ 、0.  $3 \le a \le$ 0. 8の範囲の値である)よりなる光導波層を形成する 工程と、(Alu Gara)。Inia P (ただしxiは 0 ≤ x1 < y の範囲の値であり、a は上記の範囲の値で ある) よりなる量子井戸層と、 (Alz Garz ), I  $n_1$  P (ただしx,はx, < x, < vの範囲の値であり、 a は上記の範囲の値である) よりなる量子障壁層とを繰 り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構造を 形成する工程と、(Al, Gair)。Ini。P(ただし v. a はそれぞれ上記の範囲の値である) よりなる光導 波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レーザ 素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記量子

障壁層は、分子線エピタキシー法により形成し、かつ上 50

記量子障壁層に不純物をドープすることを特徴とする半 導体レーザ素子の製造方法、(20)半導体基板上に、 (Al, Gair). Inin P (ttly, althurth 0 < v ≤ 1、0、3 ≤ a ≤ 0、8の範囲の値である)よ</p> りなる光導波層を形成する工程と、(Ala Galat) In₁ P (ただしx₁は0≤x₁<vの範囲の値であ</p> り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子井戸層 と、(A 1 2 G a 1-2 ) 。I n 1-3 P (ただしx 2 は x 1 < x2 < yの範囲の値であり、aは上記の範囲の値であ る) よりなる量子障壁層とを繰り返し設け、発光活性層 を構成する多重量子井戸構造を形成する工程と、(A1 、Gair ) . Inia P (ただしv、aはそれぞれ上記の 範囲の値である) よりなる光導波層を形成する工程とを 少なくとも有する半導体レーザ素子の製造方法におい て、上記量子井戸層及び上記量子障壁層は、分子線エピ タキシー法により形成し、かつ上記量子井戸層に不純物 をドープすることを特徴とする半導体レーザ素子の製造 方法、(21)半導体基板上に、(Al, Gai, )。I  $n_{1}$ , P (t, t, t, t), P (t, t, t), P (t, t), P (t, t), P (t, t), P (t, t), P (t), P  $\leq a \leq 0$ . 8の範囲の値である) よりなる光導波層を形 成する工程と、 (Ala Gara )。In: P (ただし x, は $0 \le x$ , < yの範囲の値であり、a は上記の範囲の 値である)よりなる量子井戸層と、(Ala Gana) In<sub>1</sub> P (ただしx₂はx₁ < x₂ < yの範囲の値であ</li> り、aは上記の範囲の値である)よりなる量子障壁層と を繰り返し設け、発光活性層を構成する多重量子井戸構 造を形成する工程と、(Al, Gair), Inia P (た だしv、aはそれぞれ上記の範囲の値である) よりなる 光導波層を形成する工程とを少なくとも有する半導体レ ーザ素子の製造方法において、上記量子井戸層及び上記 量子障壁層は、分子線エピタキシー法により形成し、か つ上記量子井戸層及び上記量子障壁層に不純物をドープ することを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法、 (22) 上記19、20又は21記載の半導体レーザ素 子の製造方法において、上記分子線エピタキシー法は、 成長温度500~600℃の範囲で行うことを特徴とす る半導体レーザ素子の製造方法によって達成される。 【0009】本発明の半導体レーザ素子の各層の材料の 組成 (Al, Gair) . Inia Pにおけるaの値は、 40 0.3から0.8の範囲の値で用いることができるが、 各層の格子定数が基板の格子定数と整合する構造となる ようにaの値を定めることが好ましい。例えば基板とし TGaAs基板を用いるときは、aを0.51とするこ とが好ましく、また基板としてGaAsP基板を用いる ときは、aを 0. 7とすることが好ましい。 【0010】発光活性層にドープする不純物種として は、p型の不純物種はZn、Mg又はBeが好ましく、 n型の不純物種はSi又はSeが好ましい。これらの不

純物の濃度は、Znの場合は5×10<sup>17</sup> ~2×10<sup>18</sup> c

m<sup>-3</sup>の範囲、Mgの場合は最大5×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>の範

(7)

囲、Beの場合は最大1×10°cm<sup>3</sup>の範囲、Siの 場合は5×10"~2×10"cm~の範囲、Seの場 合は最大5×10 °cm~0の範囲とすることが好まし

【0011】本発明の半導体レーザ素子の各層、特に発 光活性層は、有機金属気相成長法か分子線エピタキシー 法によりエピタキシャル成長させて形成することが好ま しい。有機金属気相成長法は、Alの原料として有機ア ルミニウム化合物、例えばトリメチルアルミニウム等の アルキルアルミニウム化合物、Gaの原料として有機ガ 10 リウム化合物、例えばトリメチルガリウム等のアルキル ガリウム化合物、Inの原料として有機インジウム化合 物、例えばトリメチルインジウム等のアルキルインジウ ム化合物、Pの原料としてホスフィンを用い、成長温度 650℃~750℃、定圧又は50Torr~100T orrの減圧で行うことが好ましい。圧力が減圧のとき は70Torr~80Torrで行うことがより好まし W.

【0012】また、発光活性層にドープするp型不純物 としてZnを用いるときは有機亜鉛化合物、例えばジメ 20 チル亜鉛等のアルキル亜鉛化合物を、Mgを用いるとき は有機マグネシウム化合物、例えばジメチルマグネシウ ム等のアルキルマグネシウム化合物を、Beを用いると きは有機ベリリウム化合物、例えばジメチルベリリウム 等のアルキルベリリウム化合物を原料に加える。また、 n型不純物としてSi、Seを用いるときはそれぞれホ スフィン、セレン化水素を原料に加える。

【0013】分子線エピタキシー法は、原料としてA 1、Ga、Inと、Pの原料としてのホスフィン又はP を用い、成長温度500℃~600℃で行うことが好ま 30 しい。圧力は、Pの原料としてPを用いるときは10~ "Torr~10~"Torrで行うことが好ましく、 Pの原料としてホスフィンを用いるときは10~5Tor rで行うことが好ましい。

# [0014]

【作用】本発明の作用を、GaAs基板上にエピタキシ ャル成長させた4元混晶 (Al, Gan), Inc. Pを 例として説明する。この混晶を基板と格子整合させるた めのaの値は0.51である。さて、(AlGa) ası I nae P混晶はIII族元素の秩序配列構造が生じてお り、バンドギャップエネルギーが小さい。本発明では、 (AlGa) osi Inow P混晶中におけるIII族元素 の秩序配列構造を不純物ドーピングにより抑制すること により、活性層のバンドギャップエネルギーを大きくす

【0015】しかしながら、例えばジャパニーズ・ジャ ーナル・オブ・アプライド・フィジクス、第28巻(1 989) L2092頁-L2094頁(Jpn J. A ppl. Phys., 28 (1989) L2092-L 2094) に示されているように、不純物ドーピングに 50 Asバッファ層 2 (厚み 0.5 µm、電子濃度 n<sub>1</sub> = 1

より発光強度が減少する場合があることが知られてい る。これは、不純物ドーピングによりAlGaInP混 晶において欠陥を増大させ発光効率が低下することによ ると考えられる。このため、発光活性層に不純物をドー ピングすることによりレーザ発振波長を短波長化するこ とができるが、関値電流を増大させてしまう場合があ

【0016】本発明の特に好ましい構造は、多重量子井 戸構造おいて利得の得られる量子井戸層には不純物をド ーピングしないで量子障壁層にのみ変調して不純物をド ーピングした構造である。これにより、活性領域である 量子井戸層の発光効率を低下させることなく、量子障壁 層のバリアエネルギーを増大させることができ、より短 波長でレーザ発振させることが期待できる。

【0017】例えば、フォトルミネセンスピーク波長と GaInP量子井戸層膜厚の関係を図2に示して説明す る。有機金属気相成長法により成長させた従来のアンド ープのGaInPバルク活性層ではピーク波長が665 nm (図の口印) であるのに対し、アンドープ多重量子 層及び膜厚4nmのアンドープ(Alos Gaos) ası Inos P量子障壁層)では626nm(図の○印)で あり、同じ膜厚の多重量子井戸活性層で量子障壁層にp 型不純物をドーピングしたときには620nm(図の● 印) であった。これらの値は、(Alas Gaas) asi Inum P量子障壁層が秩序配列構造である場合と無秩 序配列構造である場合のピーク波長を、それぞれバンド ギャップエネルギー570nm、551nmを用いて算 出した計算値(図にそれぞれ点線と実線で示す)の膜厚 3 nmの場合とよく一致した。

[0018] Cor (Alas Gaas ) est Ines P 量子障壁層に不純物をドーピングしたときのバリアエネ ルギーは、アンドープの場合におけるA1組成0.65 の (Alass Gaass ) ass Inass P層のバンドギャ ップエネルギーと等価であった。このことは、量子障壁 属に対する不純物変調ドープにより短波長レーザ発振が 可能であることを示す。本発明では、量子障壁層に不純 物を変調ドープしたときに630~635 nmのレーザ 発振波長が得られ、アンドープのときよりも5~6 nm 40 短い発振波長を実現できた。また、量子井戸層には不純 物をドーピングしていないときは欠陥の増大や発光効率 の低下をもたらすことなく、さらに不純物ドープした量 子障壁層のキャリアにより利得が得られることになるの で、微分利得の増大や低閾値動作が達成できた。 [0019]

# 【実施例】実施例1

本発明の一実施例の半導体レーザ素子の断面図を図1に 示し、その製造方法を説明する。後に詳述する有機金属 気相成長法により、n型GaAs基板1の上にn型Ga ×10 ° cm )、n型(Ale.7 Gae.3 ) ess In as P光導波層3 (厚み1.5 μm、電子濃度ns=1 ×10 cm~)、発光活性層 4 をエピタキシャル成長 させる。発光活性層4は、次に示す構造である。すなわ ち、この層は、膜厚3nmのアンドープGaest In 8.0 P量子井戸層10層とp型不純物Znをドープ(正 孔濃度n,=6~9×10" cm<sup>2</sup>) した膜厚4nmの (Alas Gaas) as Inas P量子障壁層 9層が交 互に設けられ、その両側に膜厚15nmの(Alas G a as ) as I now P光閉じ込め層が設けられた多重 量子井戸構造である。

【0020】次に、p型 (Alar Gaas ) ası In οω P光導波層5 (厚み1、2μm、正孔濃度n<sub>4</sub>=5 ~7×10 cm<sup>2</sup>)、p型Gaest Inee Pバッフ ァ層6 (厚み0.05 μm、正孔濃度 n<sub>4</sub> = 2×10<sup>18</sup> c m~3) を同様にエピタキシャル成長させる。

【0021】次に、ホトリソグラフィーによりSiOz マスク (膜厚0. 2μm、ストライプ幅5μm) を形成 し、ケミカルエッチングにより光導波層5を0.2 µ m 機すところまでバッファ層6と光導波層5をエッチング 20 除去してリッジストライプを形成する。

【0022】次に、SiO2マスクを残したまま、n型 GaAs 電流狭窄兼光吸収層 7 (厚さ1.0 μm、電子 濃度n<sub>0</sub>=2×10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>) を選択成長させる。さら に、p型GaAsコンタクト層8(厚み1 um、電子濃 度 n<sub>A</sub> = 5×10<sup>18</sup> ~1×10<sup>19</sup> c m<sup>~3</sup>、上部の電子濃 度が高い)を埋め込み成長させた後、p電極9及びn電 極10を蒸着する。さらに、劈開スクライブして素子の 形に切り出し、レーザ素子を得る。

【0023】有機金属気相成長法は、A1の原料として 30 トリメチルアルミニウム、Gaの原料としてトリメチル ガリウム、Inの原料としてトリメチルインジウム、P の原料としてホスフィンを用い、成長温度700℃、圧 カ70Torrで行った。量子障壁層にp型不純物であ るZnを変調ドープする原料としてはジメチル亜鉛を用 いた。

【0024】上記多重量子井戸構造における量子障壁層 のバンド端エネルギーは量子井戸層のそれより0.42 e V高い。本実施例のレーザ素子は、室温において閾値 電流が40~50mAで動作し、レーザ発振波長が63 40 0~635 n mであった。量子障壁層に不純物をドーピ ングしない素子では、室温における関値電流は60~7 0 m A であり、レーザ発振波長は636~640 n m で あったので、本発明により低閾値電流動作と発振波長の 短波長化が実現できた。

## 【0025】実施例2

発光活性層4を構成する多重量子井戸構造の部分を次の ように代えたほかは、実施例1と同様にしてレーザ素子 を製造した。すなわち、多重量子井戸構造をp型不純物 Znをドープ (正孔濃度 nx = 6~9×10 " cm~")

した膜厚3nmのGaus Inus P量子井戸層10層 と膜厚4nmのアンドープ (Alas Gaas ) ası In 4.0 P量子障壁層 9層とが交互に設けられ、その両側に 膜厚15mmの(Ales Gaes)est Ines P光閉 じ込め層が設けられた構造とした。

【0026】この多重量子井戸構造における量子障壁層 のバンド端エネルギーは量子井戸層のそれより0.33 e V高い。本実施例のレーザ素子は、室湿において閾値 電流が60~70mAで動作し、レーザ発振波長が63 10 0~635 nmであった。不純物をドーピングしない素 子より、レーザ発振波長は約5~10nm短波長化でき た。

#### 【0027】実施例3

(8)

発光活性層4を構成する多重量子井戸構造の部分を次の ように代えたほかは、実施例1と同様にしてレーザ素子 を製造した。すなわち、多重量子井戸構造を膜厚3 nm のGaosi Inose P量子井戸層10層と膜厚4nmの (Alas Gaas) ass Inass P量子障壁層 9層とが 交互に設けられ、その両側に膜厚15 nmの(Alas

Gass ) ass I nass P光閉じ込め層が設けられた構 造のすべての層にp型不純物Znをドープ(正孔濃度n \*=6~9×10" cm3) した。

【0028】この多重量子井戸構造における量子障壁層 のバンド端エネルギーは量子井戸層のそれより0.36 e V高い。本実施例のレーザ素子は、室温において閾値 電流が60~80mAで動作し、レーザ発振波長が62 5~630nmであった。不純物をドーピングしない素 子より、レーザ発振波長は約10~15nm短波長化で きた。

【0029】以上の実施例において、有機金属気相成長 法により成長させた各層をそれぞれ分子線エピタキシー 法により成長させて同様にレーザ素子を製造した。この 場合、原料としてAl、Ga、Inと、Pの原料として のホスフィンを用い、成長温度550℃、10<sup>~5</sup>Tor rで行った。製造された各レーザ素子は、いずれも有機 金属気相成長法により製造された各レーザ素子と同様な 効果を示した。

【0030】また、以上の実施例は、発光活性層にドー プする不純物としてZnを用いたがこれに代えてMg、 Beを用いても、またn型不純物のSi、Seを用いて もほぼ同様な結果が得られた。

# [0031]

【発明の効果】本発明によれば、不純物を量子障壁層か 量子井戸層に変調ドープするかまたは多重量子井戸構造 の全部にドープすることよって、より短波長で発振する レーザ素子を実現できた。

【0032】特に不純物を量子障壁層に変調ドープする ことにより、量子障壁層のバリアエネルギーを大きくで きるので、量子準位エネルギーが増大し、より短波長で 50 発振するレーザ素子が実現できた。さらに、量子井戸層 には不純物をドーピングしないときは欠陥の増大や発光 効率の低下を招くことなく、不純物ドープした量子障壁 層におけるキャリアにより利得が得られるので、低閾値 電流で動作するレーザ素子が得られた。

【0033】本発明のレーザ素子は、温度50℃、3m W定光出力動作の寿命試験において、約2000時間経 過しても顕著な劣化が見られなかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の半導体レーザ素子の断面構 造図である。

【図2】フォトルミネセンスピーク波長と量子井戸層膜\*

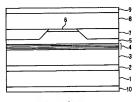
16 \*厚の関係を示す図である。

# 【符号の説明】

- 1 n型GaAs基板 2、6 バッファ層
- 3 光導波層
- 4 発光活性層
- 5 光導波層
- 7 電流狭窄兼光吸収層
- 8 コンタクト層
- 9 p電極 10
- 10 n電極

# [図1]

# **(2)** 1



1---n 型GoAs 基板

2.6---バッファイ 3...光導波層

4…発光活性層 5--光導液層

7…電流 狭窄葉光吸収層

8---コンタクト屋 9---P 電極

10---n 電播



